

2021年12月14日

各位

住所 横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号
 会社名 ジオマテック株式会社
 代表者 代表取締役社長兼CEO 松崎 建太郎
 (JASDAQコード: 6907)
 問合せ先 取締役執行役員兼CFO 河野 淳
 電話番号 045-222-5720

三井金属鉱業株式会社と協働で量産体制を整えている次世代半導体チップ
 実装用特殊ガラスキャリア「HRDP[®]」の海外向け量産出荷開始に関するお知らせ

当社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長 松崎 建太郎)は、三井金属鉱業株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長 納 武士、以下「三井金属」)が事業化を推進している次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア「HRDP[®]*1」に薄膜を提供しております。

この度、海外のICチップ実装デバイスメーカー様向けに「HRDP[®]」の量産出荷が始まりましたので、お知らせいたします。

当社は、2021年1月25日に三井金属が開発した次世代半導体チップ実装用特殊ガラスキャリア付き微細回路形成材料「HRDP[®]」が国内の複合チップモジュールメーカー様向けに量産が開始されたことをお知らせいたしました。

この度、三井金属は量産採用の第2弾として、海外のICチップ実装デバイスメーカー様向けに、2021年11月より「HRDP[®]」の量産出荷を開始いたしました。このお客様先では、「HRDP[®]」を用いて、SiP^{*2}モジュールを5G市場向けや、その他さまざまな先端用途向けで製造し拡販していくことが計画されております。

当社は、今後とも三井金属向けに安定した品質と十分な供給能力の確保を図ってまいりますとともに、価値ある薄膜製品と加工技術を提供するプロフェッショナルとしての役割を果たしてまいります。

以上

本件に関するお問い合わせ

三井金属鉱業株式会社 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部
 TEL 03-5437-8028
 E-mail PR@mitsui-kinzoku.com

ジオマテック株式会社

TEL 045-222-5720
 E-mail ir_geomatec@geomatec.co.jp

【用語説明】

※1 High Resolution De-bondable Panel の略

※2 System In Package の略